

Technische Spezifikationen

Unsere drei Hauptlieferanten sind imstande ungefähr 98 Prozent von allen unseren Aufträgen herzustellen. Die restlichen zwei Prozent bestehen aus speziellen Leiterplatten, die von spezialisierteren Herstellern produziert werden müssen.

Technische Spezifikationen	
Produktionskapazität	30.000 + 20.000 + 25.000 m ² monatlich
Multilayer	Bis zu 16 Lagen
Materialien	FR-4, Teflon®, Polyester
Mindestdicken	0.016" = 16 mil = 0.406 mm
Maximale Dicke	0.175" = 175 mil = 4.445 mm
Mindestbohrlochdurchmesser (PTH)	0.010" = 10 mil = 0.254 mm
Maximale Aspektverhältnis	1:6
Mindestleiterbreite / -abstand	0.003" = 3 mil = 0.076 mm
Mindest-SMD-Lötflächen	0.020" = 20 mil = 0.508 mm
Mindest-SMD-pitch	0.015" = 15 mil = 0.381 mm
Mindestabmessung	1.5" x 2.0" = 38.1 mm x 50.8 mm
Maximale Abmessung	18" x 24" = 457.2 mm x 609.6 mm
Kupferdicke	1 to 4 oz = 35 to 140 µ Kupferdicke
Oberflächenabschlüsse	HASL; Photosensibeler Lötstoplack (LPI); Trockenfilm und Abziehlack; Carbonlack; Galvanisch Gold (Flash Gold); Chemisch Gold-/ Nickeltauchbadbeschichtung; Hart Gold und Bondgold; Bestückungsdruck; ENTEK; Vergoldete Kontakteleisten
Test	Elektrischer Test aller Leiterplatten; Impedanzkontrolle ist möglich
Sonstiges	OEM und Leiterplattenbestückung; Produktionsstandard nach Kundenspezifikation oder IPC 600 Klasse II; Qualitätskontrolle von allen Rohwarenlieferanten; Leiterplatten werden vakuumverpackt und in Exportkisten abgeschickt; QA-Protokoll beigelegt; ISO 9002 Zertifizierung; UL Zertifizierung

Zuletzt am 30. Januar 2002 revidiert.